知財様式２

令和　　年　　月　　日

国立研究開発法人物質・材料研究機構　殿

（機関名）

（部署・職名）

（氏名）

≪知的財産権について出願・譲渡等の権限を持つ方の責任で通知して下さい≫

知的財産権実施通知書

委託研究の成果に係る知的財産権の実施について、以下のとおり通知します。

１．本通知に係る委託研究の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） |
| テーマ名 | サブ課題＿　○○○○ |
| 研究開発課題名 |  |
| プロジェクト名 |  |
| 契約番号 |  |
| 研究担当者及び所属・職名(研究実施当時) |  |
| 研究期間 | 年　月　日　～　　年　月　日 |

※研究開発課題名、プロジェクト名及び契約番号は委託研究契約書に記載の名称を記載してください。

２．対象となる知的財産権について

|  |  |
| --- | --- |
| 知的財産権の種類（注１） |  |
| 発明等の名称（注２） |  |
| 登録番号又は出願番号等（注３） |  |

３．実施等について

|  |  |
| --- | --- |
| 実施 | 自己、第三者＊（通常実施権・専用実施権等）　（注４） |
| 専用実施権等の設定を受けた者の名称および住所（注５） |  |
| 特記事項（注６） |  |

※第三者は実施許諾した場合

|  |
| --- |
| （注意事項） |
| （注１） | 種類については、委託研究契約知財条項第１条第１号において定義する知的財産権のうち、該当するものを記載してください。 |
| （注２） | 該当する①～⑤の事項を記載してください。①　発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称②　回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類（構造、技術、機能）③　植物体の品種については、農林水産植物の種類（属、種、亜種）、出願品種の名称④　著作権については、著作物の名称⑤　ノウハウについては、ノウハウの名称 |
| （注３） | 権利が登録されているものに関しては、登録番号を記載してください。登録前の特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権については出願番号（国名付記）を、著作権又はノウハウを使用する権利については管理番号を記載してください。 |
| （注４） | 自己又は第三者のいずれか（両方の場合は２つとも）を○で囲んでください。 |
| （注５） | 専用実施権等の設定を受けた者が複数ある場合は、すべてを記載してください。 |
| （注６） | 事前申請により承認を受けている専用実施権等の設定等を通知する場合は、承認時（事前申請に対するNIMSの回答文書）におけるNIMS文書登録番号を、特記事項に記載してください。また、産業技術力強化法施行令第２条第３項に該当する専用実施権等の設定等の場合における事前申請の例外となった根拠や実施の状況の変化（実施を中止した場合等）があれば記載してください。 |

≪制度固有の取扱い ①：ＳＩＰ／ＳＩＰ２／ＳＩＰ３ＦＳ／ＳＩＰ３　共通≫

・戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）については、第三者に対し、通常実施権の許諾及び専用実施権等の設定等を行う場合は、産業技術力強化法施行令第２条第３項に該当する場合であっても例外なく知財様式４による事前申請が必要となります。